

アイスモス・テクノロジーは世界的な需要増大に対応するため、 半導体生産能力を拡張いたします

アイスモス・テクノロジーは北アイルランドのベルファスト工場に投資を行い、200mmウエハーの生産を増強します。既存の100mm、125mm、150mmウエハーおよび高度技術基盤も引き続きお客様へご提供いたします。

ベルファスト， 2021年6月15日 - 半導体産業での高まる需要と生産能力不足という環境の中、アイスモス・テクノロジー・コーポレーションは本日、北アイルランド、ベルファストの工場に投資を行い、200mmのSOIおよびSi-Si接合ウエハーの生産を拡大することを発表いたしました。この増強に加え、既存の100mm、125mm、150mmの接合ウエハーや高度技術基板は引き続き、維持いたします。

アイスモステクノロジー創設者でCEOのサミュエル・アンダーソンは以下のように述べています。「他社メーカーは基板の大口径化へとシフトしていますが、私どもは低コストで高性能な製品需要の増大に応えるために求められる技術を提供するという姿勢を維持し続けます。」

「私どもは100mmのSOIウエハーやSi-Si接合ウエハーを最後の1人になっても供給し続けます。半導体産業では125mm、150mm、そして今や200mmの生産からも離れるという流れが見られます。私どもは生産終了をお知らせするのではなく、確立され信頼された製造者として存在し続けることで、お客様の評価を維持いたします。」

大口径貼り合わせウエハー

アイスモス・テクノロジーは高品質の200mm貼り合わせウエハーをすでに供給しており、圧力センサーや、慣性MEMS、光学MEMS、拡張現実やバーチャルリアリティー用のマイクロミラーデバイス、レーザー画像検出や測距用などの材料基板として使われています。自動車産業では革新的なEVや自動運転技術が開発されており、そこではより環境に配慮した、慣性MEMS、光学MEMSなどのセンサーが数えきれないほど求められています。お客様のご要望のお答えして、アイスモスはMEMSやアナログICの分野からの需要増加に対応しております。

小口径貼り合わせウエハー

他社が大口径にシフトするなかで、アイスモスが引き続き 100mm、125mm、150mm、の SOI および Si-S 接合ウエハーや高度技術基板(キャビティーボンドウエハー含む)のデマンドへの対応を継続することで、お客様のお役に立てると確信しております。多くの MEMS やディスクリート半導体を製造されているお客様の生産ラインやプロセスフローはすでに認定されており、小口径の SOI および Si-Si 接合ウエハーの確実な供給が求められています。

アイスモステクノロジーのチーフセールスオフィサーのヒュー・グリフィンは次のように述べています。「私どものお客様は、100mm、150mm の口径に特化した装置およびプロセスフローや検査技術をすでに確立し、高度な品質レベルを求められる自動車や航空宇宙、生活、医療分野などの製品に適用しています。」

「小口径の貼り合わせウエハーを提供し続けることで、開発中の新しい技術を中断することなく継続することができ、既存製品もこの先長期にわたり生産を継続することができます」

アイスモス・テクノロジー社について

2004 年に創業された[アイスモス・テクノロジー](https://www.icemostech.com/)は、低コスト高性能のスーパージャンクション MOSFET、高度な技術基板ウエハーによる低コストでシンプルな MEMS ソリューションを提供するベストインクラスのサプライヤーです。北アイルランドのベルファストに製造拠点、米国アリゾナ州テンピに研究センター、日本の東京にデザインセンターがあります。

より詳しい情報は弊社ウェブサイトへ <https://www.icemostech.com/>

メディアのお問合せ:

Linda Capcara

Brodeur Partners

lcapcara@brodeur.com

IceMOS のコンタクト:

Hugh Griffin(英国)

IceMOS Technology

hughgriffin@icemostech.com